

令和6年4月27日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会
会長 嶋田 勇三

第226回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第226回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。また、年度初めということもあり、講演前に総会を行います。総会出席を予定されている会員の皆様におきましては、ご参加いただけますようよろしくお願いいたします。

今回は会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和6年5月23日（木） 総 会 12：30～12：50
定例講演会 13：30～16：45
技術交流会 17：00～18：00

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第3研修室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】
(Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします)
川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20
<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“半導体実装技術開発の最先端”

(1)12：30～12：50	『総会（総会出席のご連絡をいただいた方のみ）』
(2)13:30～14:30 プログラムテーマ①	『チップレット先端実装技術の最新動向』 東京工業大学 産業技術創成研究院 特任教授 栗田 洋一郎 氏 講演内容：本講演では、(1)チップレット集積技術の背景、(2)チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアムの紹介、(3)コンソーシアムの活動内容、(4)マーケット/産業動向、といった内容を紹介します。
(3)14:30～15:00 会社製品技術紹介①	『オムロン高精細・高速CT型エックス線検査技術』 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 検査システム事業本部 X線検査システム事業部 事業部長 村上 清 氏 講演内容：近年、半導体では、それぞれ最適なテクノロジーノードで製造した複数の半導体チップをインタポーザと呼ばれる基板上に載せて大規模化する「チップレット」が着目されている。搭載するチップの数が多くなると、それぞれのチップに対して検査が必要になり、必要な検査が増加。さらに、基板上に複数のチップを並べる2.5Dパッケージから、チップを積層する3Dパッケージに進化するにつれて、電極の直径はフリップチップ実装に用いられるC4バンパで数十μm、2.5D/3Dパッケージで用いられるμバンパでは小さい場合には数μmに至るなど、はんだの箇所が増加し、小型化している。 また、チップとインタポーザ、基板間の距離やはんだのボイド（はんだの中の気泡）に関する検査のニーズが出ている。距離が大きくなると半導体の性能に影響するのはもちろん、はんだが小さくなるにつれて、ボイドがもたらす影響が大きくなっている。本講演では、非破壊で高速に検査できるオムロン「VT-X950」に搭載された技術について、実現の背景含め、解説する。
15:00～15:15	— 休憩 —
(4)15:15～15:45 会社製品技術紹介②	『東レグループの半導体関連製品のご紹介』 東レ株式会社 ネクストモビリティ室 半導体事業担当部長 矢部 雅美 氏 講演内容：東レグループは、半導体製造工程で使われる素材や機能材料だけでなく、半導体製造装置や検査装置、超純水製造や排水処理・回収に使われる水処理膜、最先端半導体デバイスの分析技術など、様々な製品やサービスをタイムリーにご提供することで、お客様の課題解決に貢献している。本講演では、特に実装工程に関わる材料、装置、分析技術などを中心に紹介する。

<p>(5)15:45～16:45 プログラムテーマ②</p>	<p>『光のインターフェースを持ったSSDおよびAIに関する研究開発事例』 キオクシア株式会社 先端技術研究所 AI・システム研究開発センター 技監 藤本 竜一 氏 講演内容：キオクシアの製品である NAND フラッシュメモリやSSD (Solid-State Drive) の技術課題を紹介し、将来へ向けた取り組みとして、光のインターフェースをもったSSD およびAI に関する研究開発事例に関して紹介する。</p>
<p>17:00～18:00</p>	<p>－ 技術交流会 － 産業振興会館2階「カフェサウダージ」にて</p>

4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。
会員外：22,000円/人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場とZoomウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：参加形式はZoomウェビナーのみになります。ホームページのお問い合わせフォーム

（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に第226回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和6年5月14日（火）

会員外 令和6年5月9日（木）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoomウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日1週間前に郵便で発送させていただきます（企業正会員は登録代表者（連絡担当者）にお送りします）。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田
携帯：090-5403-1147 (相良)、090-5301-9467 (太田)
E-mail: j.jisso.org@gmail.com URL: <http://www.j-jisso.org/index.html>